

台灣積體電路製造股份有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

公開說明書

(發行 111 年度第 3 期無擔保普通公司債)

- 一. 公司名稱：台灣積體電路製造股份有限公司
- 二. 本公開說明書編印目的：發行 111 年度第 3 期無擔保普通公司債。
- 三. 發行公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及配售方式：
 - (1) 種類：無擔保普通公司債。
 - (2) 金額：新臺幣 61 億元整。
 - (3) 利率：本公司債票面利率為固定年利率 1.50%。
 - (4) 發行條件：
 1. 名稱：台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債。
 2. 發行總額：發行總額為新臺幣 61 億元整，並依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 4 月 8 日證櫃債字號 1110003029 號函，取得綠色債券資格認可。
 3. 票面金額：新臺幣壹仟萬元壹種。
 4. 發行期間：5 年期，自民國 111 年 5 月 20 日開始發行，至民國 116 年 5 月 20 日到期。
 5. 發行價格：依票面金額十足發行。
 6. 還本方式：到期一次還本。
 7. 計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。本公司債付息金額每壹仟萬元計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
 8. 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
 9. 債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
 - (5) 公開承銷比例：百分之百對外公開承銷。
 - (6) 承銷及配售方式：委託承銷商對外公開承銷(洽商銷售)。
 - (7) 銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 四. 本次資金運用計畫之用途及可能產生效益概要：支應本公司綠建築及綠色環保相關之資本支出，預計可能產生效益請參閱本公開說明書參、資金用途。
- 五. 本次發行之相關費用：
 - (1) 承銷費用：新臺幣 6,100 仟元整。
 - (2) 其他費用：約新臺幣 370 仟元整。
- 六. 有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七. 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八. 股票面額：每股面額新臺幣 10 元整。
- 九. 投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項。
- 十. 查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

一、本次發行前實收資本之來源：

單位：新臺幣仟元

資 本 來 源	金 額	佔 實 收 資 本 額 比 率
創 立	1,377,500	1%
現 金 增 資	16,888,171	7%
盈 餘 轉 增 資	241,738,691	93%
資 本 公 積 轉 增 資	7,915,207	3%
合 併 增 資	15,835,152	6%
減 資	(27,555,368)	(11%)
其 他	3,118,322	1%
合 計	259,317,675	100%

二、公開說明書之分送計劃：

(一) 陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。

(二) 分送方式：依證券主管機關之規定辦理

(三) 索取處所：請附回郵信封向本公司索取或逕洽公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)

三、公司債承銷商名稱、地址、網址及電話：

名 稱	群益金鼎證券股份有限公司	網 址	https://www.capital.com.tw
地 址	台北市松山區民生東路三段 156 號 14 樓之 3	電 話	(02)8789-8888

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱	台北富邦商業銀行股份有限公司	網 址	http://www.fubon.com
地 址	台北市仁愛路四段 169 號	電 話	(02)2771-6699

六、公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱	中國信託商業銀行 代理部	網 址	https://www.ctbcbank.com
地 址	台北市重慶南路一段 83 號 5 樓	電 話	(02) 6636-5566

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱	中華信用評等股份有限公司	網 址	http://www.taiwanratings.com
地 址	台北市松山區敦化北路 167 號 2 樓	電 話	(02)2175-6800

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所		
會計師姓名	江美艷會計師		
地 址	台北市信義區松仁路 100 號 20 樓	電 話	(02)2725-9988
網 址	http://www.deloitte.com.tw		
律師事務所名稱	一誠聯合法律事務所		
律 師 姓 名	郭惠吉律師		
地 址	台北市大安區信義路三段 106 號 9 樓之 4	電 話	(02)2325-3748
網 址	無		

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所		
會計師姓名	江美艷會計師、林尚志會計師		
地 址	台北市信義區松仁路 100 號 20 樓	電 話	(02)2725-9988
網 址	http://www.deloitte.com.tw		

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名	黃 仁 昭	代理發言人姓名	高 孟 華
職 稱	副總經理暨財務長	職 稱	公共關係部主管
電 話	(03)563-6688	電 話	(03)563-6688
電子郵件信箱	press@tsmc.com	電子郵件信箱	press@tsmc.com

十三、公司網址：<https://www.tsmc.com>

台灣積體電路製造股份有限公司

公開說明書目錄

目錄

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料	1
貳、發行辦法	3
參、資金用途	4
附錄一：本次發行之董事會議事錄	
附錄二：綠色債券投資計畫書	
附錄三：證券承銷商總結意見	
附錄四：證券承銷商出具不收取退佣之聲明書	

註：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條，發行人申報發行普通公司債，如銷售對象僅限財團法人櫃檯買賣中心國際債券管理規則所定之專業投資人者，所檢具之公開說明書編製內容，應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理，應載明發行人基本資料、發行辦法及資金用途。

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料

台灣積體電路製造股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額:新臺幣 259,318 百萬元	公司地址: 新竹科學園區新竹市力行六路 8 號	電話: (03) 563-6688
設立日期: 76 年 02 月 21 日	網址: http://www.tsmc.com.tw	
上市日期: 83 年 09 月 05 日	上櫃日期: 不適用	公開發行日期: 81 年 10 月 30 日
負責人員: 董事長 劉德音	發行人: 黃仁昭 (副總經理暨財務長) 代理發言人: 高孟華 (公共關係部主管)	
股票過戶機構: 中國信託商業銀行 代理部	電話: (02) 6636-5566	網址: https://www.ctbcbank.com 地址: 台北市重慶南路一段 83 號 5 樓
股票承銷機構: 不適用	電話: (02) 8789-8888	網址: http://www.capital.com.tw
債券承銷機構: 群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商	地址: 台北市松山區民生東路三段 156 號 14 樓之 3	
最近年度簽證會計師: 勤業眾信聯合會計師事務所 江美艷、林尚志	電話: (02) 2725-9988	網址: http://www.deloitte.com.tw 地址: 台北市信義區松仁路 100 號 20 樓
複核律師: 不適用	電話: -	網址: - 地址: -
信用評等機構: 中華信用評等股份有限公司	電話: (02) 2175-6800	網址: http://www.taiwanratings.com 地址: 台北市松山區敦化北路 167 號 2 樓
評等標的	發行公司: 台灣積體電路製造股份有限公司 無 <input type="checkbox"/> ; 有 <input checked="" type="checkbox"/> , 評等日期: 110 年 11 月 16 日	
	評等等級: twAAA 本次發行公司債: 111 年度第 3 期無擔保普通公司債 無 <input checked="" type="checkbox"/> ; 有 <input type="checkbox"/> , 評等日期: - 評等等級: -	
董事選任日期: 110 年 7 月 (任期: 三年)	監察人選任日期: 不適用	
全體董事持股比例: 6.56% (111 年 4 月 30 日)	全體監察人持股比例: 不適用	
董事、監察人及持股 10% 以上股東及其持股比例: (111 年 4 月 30 日)		
職稱	姓名	持股比例
董事長	劉德音	0.05%
副董事長	魏哲家	0.02%
董事	龔明鑫	6.38%
董事	曾繁城	0.11%
獨立董事	彼得·邦菲爵士	-
獨立董事	陳國慈	-
獨立董事	麥可·史賓林特	-
獨立董事	摩西·蓋弗瑞洛夫	-
獨立董事	海英俊	-
獨立董事	拉斐爾·萊夫	-
工廠地址:	二廠、五廠	新竹科學園區園區三路121號
	三廠	新竹科學園區研新一路9號
	六廠	南部科學園區南科北路1號
	八廠	新竹科學園區力行路25號
	十二廠A廠	新竹科學園區力行六路8號
	十二廠B廠	新竹科學園區園區二路168號
	十四廠A廠	南部科學園區南科北路1號之1
	十四廠B廠	南部科學園區南科九路17號
	十五廠A廠	中部科學園區科雅六路1號
	十五廠B廠	中部科學園區新科路1號
	十八廠	南部科學園區北園二路8號
	先進封測一廠	新竹科學園區研新二路6號
	先進封測二廠	南部科學園區南科北路1號之1
	先進封測三廠	桃園市龍潭區龍園六路101號
	先進封測五廠	中部科學園區科雅西路5號
電話:	(03)5636688	
電話:	(03)5636688	
電話:	(06)5056688	
電話:	(03)5636688	
電話:	(03)5636688	
電話:	(06)5056688	
電話:	(06)5056688	
電話:	(04)27026688	
電話:	(04)27026688	
電話:	(06)5056688	
電話:	(03)5636688	
電話:	(06)5056688	
電話:	(03)5636688	
電話:	(04)27026688	
主要產品: 積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計及光罩製造等代工業務	市場結構: 內銷 16%、外銷 84%	
風險事項	不適用	
去(110)年度	營業收入: 新臺幣 1,587,415 百萬元 買賣業: - 百萬元 加工業: - 百萬元 製造業: 新臺幣 1,587,415 百萬元 稅前純益: 新臺幣 663,126 百萬元 每股盈餘: 23.01 元(稅後基本)	
本次募集發行有價證券種類及金額	種類: 無擔保普通公司債; 發行金額為新臺幣陸拾壹億元整	

發行條件	5 年期，利率 1.50%。(請參閱公開說明書 貳、發行辦法)	
募集資金用途及預計產生效益概述	資金用途：支應本公司綠建築及綠色環保相關之資本支出 預計產生效益：請參閱公開說明書參、資金用途	
本次公開說明書編印日期：	111 年 5 月 12 日	刊印目的：發行 111 年度第 3 期無擔保普通公司債
其他重要事項之扼要說明及參閱本文頁次：無		

貳、發行辦法

台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱「本公司」）經呈奉 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第 11100041281 號函申報生效發行公司債，並依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 4 月 8 日證櫃債字第 1110003029 號函，取得綠色債券資格認可，訂定發行辦法如下

- 一、債券名稱：台灣積體電路製造股份有限公司111年度第3期無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
- 二、發行總額：發行總額為新臺幣 61 億元整。
- 三、票面金額：新臺幣壹仟萬元整。
- 四、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、發行期間：5 年期，自 111 年 5 月 20 日開始發行，至 116 年 5 月 20 日到期。
- 六、票面利率：固定年利率 1.50%。
- 七、還本方式：到期一次還本。
- 八、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。本公司債付息金額每壹仟萬元計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
- 九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- 十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十一、受託人：本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。
- 十三、承銷機構：群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)公告之。
- 十五、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 十六、本公司債係為取具綠色債券資格認可之債券，所募集資金之使用範圍及相關管理或資訊揭露作業等，除有關規定外，另依據本公司所訂定之綠色債券投資計畫書辦理，投資計畫書內容請參閱本公司債公開說明書。

參、資金用途

一、發行公司債資金運用計畫分析

(一) 資金來源：

1. 目的事業主管機關核准日期及文號：不適用。
2. 本計畫所需資金總額：本次計畫項目包含 F18P6 綠建築、F18P7 綠建築、F14P8 綠建築、台中零廢處理中心及 WWT 廢水處理系統，總投資金額預計約為新臺幣 518 億元。
3. 資金來源：本次計畫所需總投資之資金來源除已發行 111 年度第 1 期無擔保普通公司債新臺幣 54 億元支應部分 F18P6 綠建築、F18P7 綠建築及台中零廢處理中心外，本次將另發行 111 年度第 3 期無擔保普通公司債新臺幣 61 億元支應部分專案投資金額，不足之金額計畫將以台積公司自有資金或另發行綠色債券支應。
4. 計畫項目及預定運用進度：

單位：新臺幣佰萬元

計畫項目	專案投資總金額	以 111-3 綠色債券資金支應金額		
		償還融資	新支出	小計
F18P6 (綠建築)	15,138	0	729	729
F18P7 (綠建築)	18,525	0	2,277	2,277
F14P8 (綠建築)	12,100	0	1,733	1,733
台中零廢製造中心	3,169	0	591	591
WWT 廢水處理系統	2,894	0	770	770
總計	51,826	0	6,100	6,100

註：專案投資總金額將視實務進行狀況予以調整

本公司預期綠色債券募集資金之各年度預計資金運用分配規劃如下表，然實際運用情形將視實務進行狀況予以調整。

單位：新臺幣佰萬元

計畫項目	111 年				小計
	Q1	Q2	Q3	Q4	
F18P6 綠建築	-	370	359	-	729
F18P7 綠建築	-	1,118	1,159	-	2,277
F14P8 綠建築	-	670	1,063	-	1,733
台中零廢製造中心	-	58	533	-	591
WWT 廢水處理系統	-	256	514	-	770
總計	-	2,472	3,628	-	6,100

(二) 本次發行公司債依公司法第二百四十八條規定，應揭露事項：

1. 公司名稱：台灣積體電路製造股份有限公司。
2. 公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新臺幣 61 億元整，每張票面金額新臺幣壹仟萬元整。
3. 公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率 1.50%。
4. 公司債償還方法及期限：到期一次還本。
5. 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將以營業收入支應。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
6. 公司債募得價款之用途及運用計畫：資金用途為支應本公司綠建築及綠色環保相關之資本支出；資金運用計畫詳本公開說明書第 4 至 8 頁。
7. 前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國 110 年 12 月 31 日止，公司債未償還餘額為新臺幣 2,571 億元及美金 20 億元、子公司 TSMC Global Ltd. 發行之公司債美金 65 億元整、及子公司 TSMC Arizona Corp. 發行之公司債美金 45 億元整 (截至民國 111 年 5 月 5 日止，公司債未償還餘額為新臺幣 2,767 億元及美金 20 億元、子公司 TSMC Global Ltd. 發行之公司債美金 65 億元整、及子公司 TSMC Arizona Corp. 發行之公司債美金 80 億元整)。
8. 公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。
9. 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至民國 110 年 12 月 31 日止，核定股本額為新臺幣 280,500,000,000 元整，每股面額新臺幣 10 元整，實收資本總額為新臺幣 259,303,804,580 元整，分為 25,930,380,458 股。
10. 公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：截至民國 110 年 12 月 31 日止，該項餘額為新臺幣 2,170,733,205 仟元整。
11. 證券管理機關規定之財務報表：不適用。
12. 公司債權人之受託人名稱及其約定事項：
本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂定受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
13. 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
14. 有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商，依簽定之承銷契約辦理相關承銷及應募等事宜。
15. 有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
16. 有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
17. 對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
18. 可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

19. 附認股權者，其認購辦法：不適用。
20. 董事會之議事錄：請參閱附錄之董事會會議紀錄。
21. 公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。

(三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響。

1. 本次發行公司債之可行性評估：

本次公司債之計畫發行金額為新臺幣61億元，每張面額為新臺幣壹仟萬元，按面額發行。本公司債採對外公開承銷之方式，洽特定人認購，足以確保本次資金募集之完成，故本次募集資金計畫應屬可行。

2. 本次發行公司債之必要性評估：

本次發行公司債之資金將用於支應本公司綠建築及綠色環保相關之資本支出，以支持公司達成長期成長及綠色製造之目標，故本次發行公司債應屬必要。

3. 本次發行公司債之合理性評估：

本次公司債採固定利率發行，由於目前國內長期利率水準尚屬低廉，故發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。

4. 分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

(1) 各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

綜觀上市（櫃）公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權之相關籌資工具，前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等，後者如現金增資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：

項目	有利因素	不利因素	
債權	普通公司債	<ol style="list-style-type: none"> 1.可取得中、長期穩定之資金。 2.借貸成本相對低廉。 3.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 4.債息列為費用，具節稅效果。 5.運用財務槓桿，提高股東權益。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.相較於股權籌資，將形成利息負擔。 2.將使負債比率增加。
	銀行借款	<ol style="list-style-type: none"> 1.資金調度運用彈性較大。 2.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 3.債息列為費用，具節稅效果。 4.運用財務槓桿，提高股東權益。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.較不利於長期資金之取得 2.相較於股權籌資，將形成利息負擔。 3.將使負債比率增加。
	可轉換公司債	<ol style="list-style-type: none"> 1.因附有轉換權利，票面利率較公司債低。 2.相較於股權籌資，可延緩或不造成每股盈餘及股權稀釋。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.轉換前將使負債比率增加。 2.轉換後將稀釋每股盈餘及股權。
股權	現金增資	<ol style="list-style-type: none"> 1.無利息支出。 2.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.稀釋每股盈餘及股權。 2.無節稅效果。
	美國存託憑證(ADR)	<ol style="list-style-type: none"> 1.無利息支出。 2.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.稀釋每股盈餘及股權。 2.無節稅效果。 3.發行成本較高，為達成規模經濟

	3.募資對象以國外法人為主，可免增資新股釋出，致國內流通股數膨脹，對股價產生不利影響。	效益，募資額度不宜過低。
--	---	--------------

(2) 對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集資金，除可掌握長期資金來源，亦可避免每股盈餘及股權稀釋。由於目前市場利率處於低點，故利息負擔尚屬合理，對每股盈餘無重大影響。

(四) 本次發行價格之訂定方式：本次發行價格參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同期利率交換合約，再依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益

1. 收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構(含總成本及單位成本)、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：

綠色投資計畫名稱	綠色投資計畫類別	環境效益說明
F18P6 綠建築	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別：其他氣候變遷調適或經本中心認可者(綠建築) ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別：符合地區、國家或國際認可標準或認證的綠色建築 	<p>已於 2021 年 11 月 26 日取得候選綠建築證書(候選綠建築證書字號:CGB-GF-01-00118)。</p> <p>台積公司將依循過往綠色足跡，預計 2023 年完工後申請台灣綠建築標章、美國 LEED BD+C 認證，以取得台灣綠建築標章黃金級以上，美國 LEED BD+C 黃金級認證為目標。透過綠建築認證，可以降低其興建過程及營運階段的各項資源如水、電耗用。除了有效節約能源，減少二氧化碳排放，同時達到廢棄物減量，降低對環境影響，增加建築物之氣候韌性。</p>
F18P7 綠建築	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別：其他氣候變遷調適或經本中心認可者(綠建築) ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別：符合地區、國家或國際認可標準或認證的綠色建築 	<p>已於 2021 年 11 月 26 日取得候選綠建築證書(候選綠建築證書字號:CGB-GF-01-00119)。</p> <p>台積公司將依循過往綠色足跡，預計 2023 年完工後申請台灣綠建築標章、美國 LEED BD+C 認證，以取得台灣綠建築標章黃金級以上，美國 LEED BD+C 黃金級認證為目標。透過綠建築認證，可以降低其興建過程及營運階段的各項資源如水、電耗用。除了有效節約能源，減少二氧化碳排放，同時達到廢棄物減量，降低對環境影響，增加建築物之氣候韌性。</p>
F14P8 綠建築	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別：其他氣候變遷調適或經本中心認可者(綠建築) ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別：符合地區、國家或國際認可標準或認證的綠色建 	<p>為取得綠建築標章候選合格證書，已於 2022 年 4 月送審查，預計 2022 年 9 月取得候選綠建築證書。</p> <p>台積公司將依循過往綠色足跡，預計 2023 年完工後申請台灣綠建築標章、美國 LEED BD+C 認證，以取得台灣綠建築標章黃金級</p>

	築	以上，美國 LEED BD+C 黃金級認證為目標。透過綠建築認證，可以降低其興建過程及營運階段的各項資源如水、電耗用。除了有效節約能源，減少二氧化碳排放，同時達到廢棄物減量，降低對環境影響，增加建築物之氣候韌性。
台中零廢製造中心	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 溫室氣體減量 ■ 廢棄物回收處理或再利用 ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 汙染防治 ■ 循環經濟產品、生產技術及流程 	經由台中零廢製造中心處理，6 項物料總計回收/處理廢棄物年總量約 13.7 萬噸，約當每年減碳 3.8 萬噸。(由 10.1 萬噸降至 6.3 萬噸，依此 6 項物料為範疇，約當減碳 40%)
Waste Water Treatment, WWT (廢水處理系統)	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 水資源節約、潔淨或回收循環再利用 ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別： ● 可持續水資源與廢水管理 	WWT 專案預計將使 F18P6/F18P7/F14P8 之 8 項主要汙染物以優於科學園區放流水納管標準排放(+25%~+97%)，並同時每年回收 1,873 萬噸廢水，回收率約 85%，創造之回收水效益約為新台幣 2.2 億

本次資金運用為支持節能減碳之政策，持續推動綠色製造，其項目對環境保護、公司整體形象及長期營運發展有正面助益，非用於擴建廠房設備，增加產銷量，故無相關營收產生。

2. 轉投資其他公司者應列明事項：不適用。
3. 充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項：不適用。
4. 如為購買營建用地或支付營建工程款者：不適用。
5. 如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者：不適用。

(六) 本公司債係依據財團法人中華民國證券櫃買中心 111 年 4 月 8 日證櫃債字第 1110003029 號函，取得綠色債券資格認可。有關本綠色債券之投資計畫及環境效益評估、投資計畫評估及篩選流程、資金運用計畫及發行後資金運用報告之相關事項，將依照本公司訂定之「綠色債券投資計畫書」所執行，請參閱本公司債公開說明書附錄二。

(七) 本次綠色債券投資計畫書之(一)綠色投資計畫及環境效益評估及(二)綠色投資計畫之評估與篩選流程委由立恩威國際驗證股份有限公司出具評估意見；(三)資金運用計畫及(四)發行後資金運用報告之相關事項委由勤業眾信聯合會計師事務所出具有限確信報告。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

台灣積體電路製造股份有限公司

董事會會議記錄

(中華民國一百一十一年度第一次董事常會)

(節錄本)



時 間： 壹、中華民國一百一十一年二月十四日（下午4:00）

貳、中華民國一百一十一年二月十五日（上午9:00）

地 點： 新竹科學園區新竹市力行六路八號（視訊會議）

親自出席董事共十人：劉德音、魏哲家、曾繁城、Peter L. Bonfield、陳國慈、
Michael R. Splinter、Moshe N. Gavriellov、海英俊、
L. Rafael Reif、龔明鑫

主 席： 劉德音 博士

記 錄： 方淑華

列席及報告人員：（略）

（前略）

十、 決議事項

（第一項至第十九項略）

第二十項： 提請本會核准於（1）不高於新台幣 60,000,000,000 元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以及（2）不高於美金 1,000,000,000 元之額度內於台灣國際債券市場分次募集美元無擔保普通公司債，以支應本公司產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求，並核准就上述公司債向主管機關申請發行，於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌交易；另請授權董事長或其指定之人決定上述公司債之主要發行條件、發行時間、計畫項目、預計可能產生效益及其他相關事項。

經提案表決全體出席董事一致通過決議如下：

決議：照案通過。

（後略）

十一、 經詢無其他臨時動議，本會議程結束。

台灣積體電路製造股份有限公司

綠色債券投資計畫書

中華民國 111 年 3 月

目錄

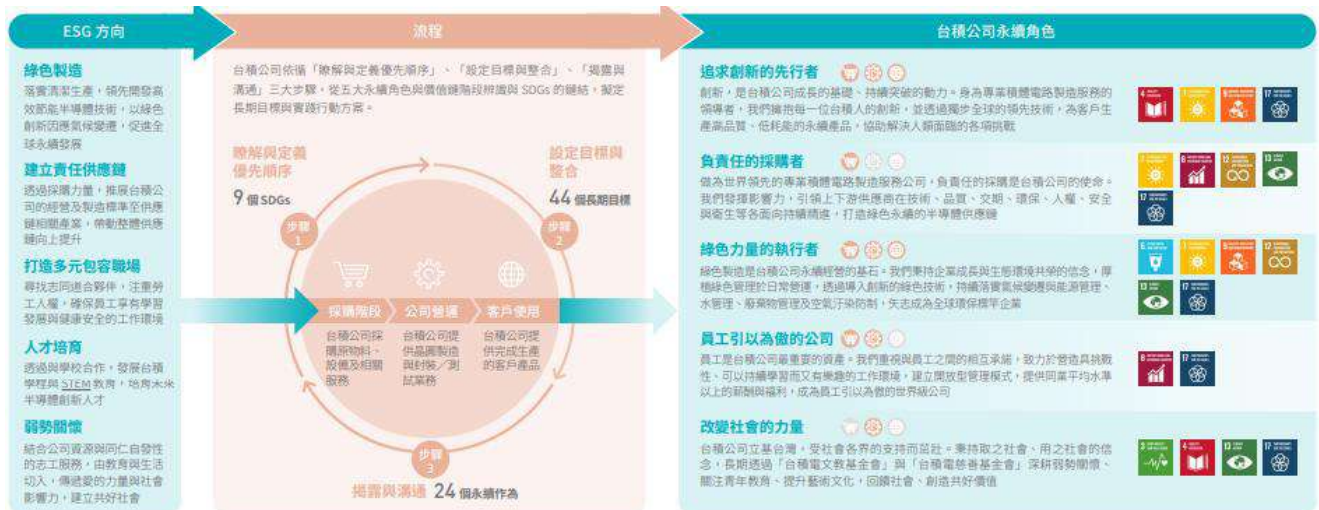
永續發展策略概要資訊及目標.....	2
台積公司綠建築.....	3
綠色債券投資計畫依循之標準.....	5
綠色投資計畫及環境效益評估 (Use of proceeds).....	5
1) 綠色債券投資項目說明.....	5
2) 綠色投資計畫類別及環境效益評估.....	7
綠色債券投資計畫之評估及篩選流程 (Process for evaluation and selection).....	8
資金運用計畫(Management of proceeds).....	10
發行後資金運用報告之相關事項(Reporting).....	11

永續發展策略概要資訊及目標

面對全人類所面臨的嚴峻挑戰，台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱台積公司)以十大經營理念與四大價值觀為本，專注提升本業核心能力，積極落實五大永續角色，從上游採購、公司營運與客戶使用三大階段，帶動半導體產業具體實踐聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals SDGs)。在 ESG 指導委員會的帶領下，台積公司設定五大 ESG 發展方向、選定 9 個主要的 SDGs 目標，透過 ESG 委員會整合跨組織的資源與力量，擬定 44 個可衡量且具時效性的長期目標，執行 24 個相對應的永續作為，將 SDGs 融入組織文化與日常營運，並以 SDG 17 全球夥伴為核心，透過參與、合作與對話，攜手內外部利害關係人，不斷挖掘治理／經濟、環境與社會三大面向的發展契機，攜手邁向價值共享的永續未來。

其中，台積公司永續角色中-綠色力量的執行者直接點出綠色製造是台積永續經營的基石，秉持企業成長與生態環境共榮的信念，厚植綠色管理於日常營運，透過導入創新的綠色技術，持續落實氣候變遷與能源管理、水管理、廢棄物管理及空氣汙染防制，矢志成為全球環保標竿企業。

台積公司希望透過綠色債券發行募集資金，其資金除了可支持製程設備更新、流程改造及技術升級來改善溫室氣體排放及各項汙染排放數據，更希冀持續支持晶圓製造廠房與環境共生共利，並同時進一步將晶圓製造廠產生之廢棄物透過回收再利用，降低廢棄物總量，進而間接減少碳排放，實踐聯合國永續發展目標。為順利募集綠色債券資金，故訂定本計畫書說明台積公司綠色投資計畫項目。



台積公司綠建築

為響應政府推動生態城市、節能減碳、低碳社區、低碳城市之政策，利用綠建築評估工具，進行綠建築設計，有效減緩建築開發行為對地球環境的衝擊。

台積公司自民國九十五年起全面推動綠建築，以促進環保節能績效，積極投入新設廠房規劃與執行、既有工廠改善、內部教育訓練與鼓勵協力廠商執行綠建築標章認證等。為了達成目標，特別成立綠建築專責小組，採行美國 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 與台灣綠建築 EEWH (Ecology, Energy Saving, Waste Reduction, Health) 標準，擇定新建晶圓廠房與既有辦公大樓，試行 LEED 與 EEWH 認證。




台積公司綠建築認證面積全球半導體業第一，迄今共累計取得 37 座美國 LEED 綠建築認證(3 座白金級及 34 座黃金級)及 25 座台灣綠建築鑽石級 EEWH 認證(20 座鑽石級、4 座黃金級、1 座銀級)。另外，F18P4 Fab、F18P4 Office、AP2C、F18P6 Fab 及 F18P7 Fab 皆於 2021 年取得候選綠建築證書。未來待建築物完成後將著手申請 LEED 與 EEWH 認證。



Fab	F12					F15					F16
	P1/2	P3	P4/5	P6	P7	P1/2	P3/4	P5	P6	P7	P1
LEED											
EEWH											-


F12P4/5: one LEED-NC Gold, one LEED-EB Platinum

Fab	F14						Backend		F18		
	P1/2	P3	P4	P5	P6	P7	AP2B	AP3	P1	P2	P3
LEED											
EEWH							-	-			

Office	F12					F15			F16
	P1	P3	P4	P6	P7	P1	Tower	P5	P1
LEED									
EEWH	-	-							-
智慧建築	-	-		P4/6/7合併申請					-

Office	F14				F18
	P1	P3	P5	P7	P1
LEED					
EEWH	-			與FAB合併	
智慧建築	-				-

  : Under review

 : Document under Preparation

綠色債券投資計畫依循之標準

本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點及參照 International Capital Market Association (ICMA) 國際資本市場協會的 Green Bond Principles (GBP) 綠色債券準則，依下列四大要點訂定本次綠色債券投資計畫內容。

- (一) 綠色投資計畫及環境效益評估
- (二) 綠色投資計畫之評估與篩選流程
- (三) 資金運用計畫
- (四) 發行後資金運用報告之相關事項

本次投資計畫之(一)綠色投資計畫及環境效益評估及(二)綠色投資計畫之評估與篩選流程委由立威國際驗證股份有限公司出具評估意見；(三) 資金運用計畫及(四)發行後資金運用報告之相關事項委由勤業眾信聯合會計師事務所出具有限確信報告。

綠色投資計畫及環境效益評估 (Use of proceeds)

1) 綠色債券投資項目說明

綠色投資計畫名稱	地點	計畫內容說明	聯合國可持續發展目標類別
F18P6 Fab 綠建築	南部科學園區	推動廠房綠建築認證，降低廠房建築開發行為對環境之衝擊。已於2021年11月26日取得候選綠建築證書(候選綠建築證書字號:CGB-GF-01-00118)。預計2023年完工後申請台灣綠建築標章及美國 LEED BD+C 黃金級以上之認證為目標。	SDG 11: Sustainable Cities and Communities SDG 13: Climate Action
F18P7 Fab 綠建築	南部科學園區	推動廠房綠建築認證，降低廠房建築開發行為對環境之衝擊。已於2021年11月26日取得候選綠建築證書(候選綠建築證書字號:CGB-GF-01-00119)。預計2023年完工後申請台灣綠建築標章及美國 LEED BD+C 黃金級以上之認證為目標。	SDG 11: Sustainable Cities and Communities SDG 13: Climate Action
F14P8 Fab 綠建築	南部科學園區	推動廠房綠建築認證，降低廠房建築開發行為對環境之衝擊。預計於2022年9月評定通過台灣EEWH候選綠建築，2023年完工後申請台灣綠建築標章及美國LEED BD+C 黃金級以上之認證為目標。	SDG 11: Sustainable Cities and Communities SDG 13: Climate Action

台中零廢製造中心	中部科學園區	隨著產能及研發規模持續擴充，為避免廢棄物產出量同步增加，台積公司採取廢棄物產出最小化，資源循環使用最大化的廢棄物管理方針，故針對晶圓廠製造後產生之硫酸、異丙醇(IPA)、液氮、廢溶劑、CMP污泥、CaF2污泥等6項物料，經由零廢製造中心再生製或處理，提高使用後物料資源化機會，降低6項物料整體碳排放，實踐綠色製造。	SDG 12: Responsible Consumption and Production SDG 13: Climate Action
UPS Package (大型不斷電系統)	南部科學園區 (F18P6/F18P7/F14P8)	UPS可在電力異常情況下不間斷的提供穩定電源，主要運用在維持廠務系統及設備機台的穩定運轉。UPS平時在台電供給端本體不耗電，當發生電力異常時於極短時間內切換到機台電池模式供電，可省下UPS本體所消耗的能源。	SDG 13: Climate Action
Local Scrubber (現址式尾氣處理設施)	南部科學園區 (F18P6/F18P7/F14P8)	Local Scrubber利用輔助燃料或電漿產生高熱，使溫室氣體經過高溫處理後裂解，再經由水洗將污染物水解／離子化後進入液相而去除。該設備在使用端(Point-of-Use)藉由輔助燃料與氧氣操作參數之調整，運用燃燒/水洗技術來分解全氟碳化物氣體(PFCs)，可達到高效率之PFCs廢氣處理。	SDG 13: Climate Action
Waste Water Treatment, WWT (廢水處理系統)	南部科學園區 (F18P6/F18P7/F14P8)	台積將純水設備及製程機台的排放水依照其純淨程度分級，分別透過循環純化製程及廢水處理系統降低汙染排放及提高水資源使用效率。流放水標準匡列8項主要汙染物(化學需氧量、懸浮固體、氟鹽、銅離子、氨氮、砷、硼與硝酸鹽氮)，並將各廢水以對應之系統處理後，以優於科學園區放流水納管標準排放，降地廢水排放對環境的衝擊。	SDG 6: Clean Water and Sanitation SDG 13: Climate Action

2) 綠色投資計畫類別及環境效益評估

綠色投資計畫名稱	綠色投資計畫類別	環境效益說明
F18P6 綠建築	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別：其他氣候變遷調適或經本中心認可者(綠建築) ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別：符合地區、國家或國際認可標準或認證的綠色建築 	<p>已於 2021 年 11 月 26 日取得候選綠建築證書(候選綠建築證書字號:CGB-GF-01-00118)。台積公司將依循過往綠色足跡，預計 2023 年完工後申請台灣綠建築標章、美國 LEED BD+C 認證，以取得台灣綠建築標章黃金級以上，美國 LEED BD+C 黃金級認證為目標。透過綠建築認證，可以降低其興建過程及營運階段的各項資源如水、電耗用。除了有效節約能源，減少二氧化碳排放，同時達到廢棄物減量，降低對環境影響，增加建築物之氣候韌性。</p>
F18P7 綠建築	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別：其他氣候變遷調適或經本中心認可者(綠建築) ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別：符合地區、國家或國際認可標準或認證的綠色建築 	<p>已於 2021 年 11 月 26 日取得候選綠建築證書(候選綠建築證書字號:CGB-GF-01-00119)。台積公司將依循過往綠色足跡，預計 2023 年完工後申請台灣綠建築標章、美國 LEED BD+C 認證，以取得台灣綠建築標章黃金級以上，美國 LEED BD+C 黃金級認證為目標。透過綠建築認證，可以降低其興建過程及營運階段的各項資源如水、電耗用。除了有效節約能源，減少二氧化碳排放，同時達到廢棄物減量，降低對環境影響，增加建築物之氣候韌性。</p>
F14P8 綠建築	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別：其他氣候變遷調適或經本中心認可者(綠建築) ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別：符合地區、國家或國際認可標準或認證的綠色建築 	<p>為取得綠建築標章候選合格證書，預計將於 2022 年 4 月送審查，2022 年 9 月取得候選綠建築證書。</p> <p>台積公司將依循過往綠色足跡，預計 2023 年完工後申請台灣綠建築標章、美國 LEED BD+C 認證，以取得台灣綠建築標章黃金級以上，美國 LEED BD+C 黃金級認證為目標。透過綠建築認證，可以降低其興建過程及營運階段的各項資源如水、電耗用。除了有效節約能源，減少二氧化碳排放，同時達到廢棄物減量，降低對環境影響，增加建築物之氣候韌性。</p>
台中零廢製造中心	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 溫室氣體減量 ■ 廢棄物回收處理或再利用 ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 污染防治 	<p>經由台中零廢製造中心處理，6 項物料總計回收/處理廢棄物年總量約 13.7 萬噸，約當每年減碳 3.8 萬噸。(由 10.1 萬噸降至 6.3 萬噸，依此 6 項物料為範疇，約當減碳 40%)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ■ 循環經濟產品、生產技術及流程 	
UPS Package (大型不斷電系統)	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 能源使用效率提昇及能源節約 ■ 溫室氣體減量 ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 能效提升 ■ 汙染防治 	透過整流、變流穩定供電，UPS 節能效益總計為每年 2,891 萬度，相當於年減二氧化碳 14,511 噸
Local Scrubber (現址式尾氣處理設施)	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 溫室氣體減量 ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 汙染防治 	Local Scrubber 專案加總之減碳效益為每年減少 113.3 萬噸 CO ₂ 排放，環境損益評估 (EP&L) 效益為每年約 NT\$17.5 億。
Waste Water Treatment, WWT (廢水處理系統)	<ul style="list-style-type: none"> ● 櫃買中心永續發展債券作業要點綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 水資源節約、潔淨或回收循環再利用 ● ICMA 之 GBP 綠色投資計畫類別： <ul style="list-style-type: none"> ■ 可持續水資源與廢水管理 	WWT 專案預計將使 F18P6/F18P7/F14P8 之 8 項主要汙染物以優於科學園區放流水納管標準排放(+25%~+97%)，並同時每年回收 1,873 萬噸廢水，回收率約 85%，創造之回收水效益約為新台幣 2.2 億

註：環境效益會依預估處理量或依照公司實務需求而進行調整及揭露

綠色債券投資計畫之評估及篩選流程 (Process for evaluation and selection)

奠基於基業長青的永續使命，台積公司堅守經營理念與誠信正直、創新、承諾、客戶信任四大價值觀，專注提升本業核心能力，積極實踐聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)。為遵循《台積公司企業社會責任政策》的願景與使命，台積公司接軌國際永續趨勢，設立「企業社會責任執行委員會 (民國 110 年起，更名為 ESG 指導委員會)」為內部最高層級的 ESG 決策中心，由董事長擔任主席，ESG 委員會主席擔任執行秘書，與多位不同領域的高階主管共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期 ESG 發展方向，合力擘畫鏈結台積公司核心優勢的聯合國永續發展目標推動藍圖。

為確保落實 ESG 指導委員會決議，台積公司以 ESG 委員會為跨部門溝通平台，由董事長指派高階主管擔任委員會主席，接軌國際標準、洞察國際趨勢，建立由上而下、橫向串聯的運作方式，領導各組織委員擬定永續議題的年度執行策略與目標，追蹤執行成效，積極平衡各利害關係人的利益，充份落實 ESG 策略於台積公司日常營運中。

ESG 執行方針之強化環保方面，台積公司致力於環境永續，持續推動綠色廠房、綠色製造與綠色供應鏈，追求能源與資源最佳使用效率，並積極投入減廢與污染防治。

秉持著上述環保執行方針，為持續節能減碳及確保環境永續，且遵循台積公司綠色製造精神，台積公司專業團隊包含企業環保安全衛生處、廠務處及財務處等，除考量綠建築廠房可以降低興建過程及營運階段之各項資源耗用、增加建物的氣候韌性外，另根據減少資源耗用、溫室氣體及廢棄物排放減量之標準及環境損益(Environmental Profit and Loss, EP&L)等評估工具來進行篩選及評估。

資金運用計畫(Management of proceeds)

● 資金運用計畫項目

本次綠色債券投資計畫書所列之計畫項目，其專案總投資金額約為新台幣 566 億元，除前次發行之 111 年度第 1 期無擔保普通公司債新臺幣 54 億元外，預計將另發行綠色債券以其資金支應，金額上限為新台幣 200 億元整。

計畫項目	專案投資總金額 (新台幣佰萬元)
F18P6 (綠建築)	15,138
F18P7 (綠建築)	18,525
F14P8 (綠建築)	12,100
台中零廢製造中心	3,169
UPS Package	2,479
Local Scrubber	2,278
廢水處理系統(WWT)	2,894
總計	56,583

註：預計資金用途規劃及金額將依照公司或市場實務需求進行調整

● 資金運用之控管機制

1. 綠色投資計畫進度與執行情形管理

- A. 每項綠色投資計畫下皆設有多筆 JCAN 及 PO 號碼，透過 JCAN/SAP 系統，可完整記錄及追蹤每筆綠色投資之採購、核准、發包、驗收、請款、立帳及銷核。
- B. 執行情形將由廠務處透過 iDC (Document Center) 系統進行簽核及管理。該部門與財務規劃部將對綠色投資計畫執行進度及預計可產生之環境效益進行追蹤，以確保綠色資金投入之有效性。

2. 資金運用紀錄與管理

本公司將紀錄所募資金之使用狀況，以確保綠色債券取得之資金運用於符合本公司綠色投資計畫之項目。

- A. 發行綠色債券募集資金後，將匯入本公司指定帳戶，後續動撥資金或付款將以 SAP 系統進行帳務紀錄。
- B. 綠色資金運用紀錄
財務規劃部每月將向廠務處彙集綠色投資計畫項目 PO 紀錄，並同時向應付帳款課取得付款紀錄予以調節核對，另外定期與財務處資金調度部就綠色債券所募資金之動撥紀錄及帳上餘額進行調節核對，以追蹤及確保其資金運用符合綠色投資

計畫之資金用途。

3. 未動撥資金之保管及運用

綠色債券所募資金將因應本公司綠色投資計畫執行需求撥款運用，未動撥餘額將依公司財務處資金調度部規劃存於活期存款或定期存款。

發行後資金運用報告之相關事項(Reporting)

本公司將依循財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「永續發展債券作業要點」規定，於綠色債券存續期間或所募資金運用期間，於每年自行訂定之期限(每年 4/30 前)出具年度資金運用報告，報告內容將包含資金運用情形(綠色債券基本資料、綠色投資計畫清單與簡介、實際資金分配及運用情形、未動撥資金之管控方式)及環境效益等，另委由勤業眾信聯合會計師事務所出具資金運用情形是否符合投資計畫書之評估意見或確信報告。前開年度資金運用報告及認證機構所出之評估意見或確信報告將於前述期間內，輸入櫃買中心指定之網際網路申報系統。

本公司預計將於債券發行後下一年度揭露綠色投資計畫之效益衡量指標如下表所示：

類別	預期之效益衡量指標
綠建築	<ul style="list-style-type: none"> ● 專案進度 ● 專案預計取得之綠建築認證或標章 ● 其他環境效益說明
廢棄物回收處理或再利用	<ul style="list-style-type: none"> ● 專案年度回收及處理量估計(噸) ● 專案年度約當減碳量估計(噸)
能源使用效率提昇及能源節約	<ul style="list-style-type: none"> ● 專案年度節電效益估計(度) ● 專案年度約當減碳量估計(噸)
溫室氣體減量	<ul style="list-style-type: none"> ● 專案年度約當減碳量估計(噸) ● 其他效益說明
水資源節約、潔淨或回收循環再利用	<ul style="list-style-type: none"> ● 專案年度廢水回收量估計(噸) ● 專案年度預計回收率 ● 其他效益說明

台灣積體電路製造股份有限公司



董事長：劉德音



承銷商總結意見

(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

台灣積體電路製造股份有限公司本次為發行 111 年度第 3 期無擔保普通公司債，發行總額為新臺幣 61 億元整，每張面額均為新臺幣壹仟萬元壹種，並委託本承銷商對外公開銷售，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本承銷商採取必要程序予以複核，特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，台灣積體電路製造股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

此致

台灣積體電路製造股份有限公司

群益金鼎證券股份有限公司

董事長 王濬智

承銷部門主管 張嘉紋



中 華 民 國 111 年 5 月 5 日

聲明書

本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

負 責 人：王濬智



日 期：111 年 5 月 5 日



聲明書

本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：富邦綜合證券股份有限公司

負責人：韓蔚廷

日期：111 年 5 月 11 日



聲明書

本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：元富證券股份有限公司

負責人：董事長 陳俊宏

日期：111 年 5 月 11 日



聲明書

本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：凱基證券股份有限公司

負責人：許道義

日期：111 年 5 月 11 日



聲明書

本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：國泰世華商業銀行股份有限公司

負責人：郭明鑑

日期：111 年 5 月 11 日



聲明書

本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：統一綜合證券股份有限公司

負責人：林寬成



日期：111 年 5 月 11 日

聲明書

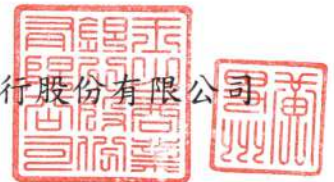
本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：玉山商業銀行股份有限公司

代 表 人：黃 男 州

日 期：111 年 5 月 11 日



聲明書

本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：中國信託綜合證券股份有限公司

負責人：陸子元



日期：111 年 5 月 11 日



聲明書

本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：台新國際商業銀行股份有限公司

負責人：尚瑞強

日期：111 年 5 月 11 日



聲明書

本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 3 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：台北富邦商業銀行股份有限公司

負責人：陳聖德



日期：111 年 5 月 11 日

台灣積體電路製造股份有限公司



董事長：劉 德 音

